

证券代码：300735

证券简称：光弘科技

公告编号：2025-006号

惠州光弘科技股份有限公司

关于向 All Circuits S.A.S.及 GDL Circuits S.A. de C.V.提供借款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司 All Circuits Holdings (Singapore) Pte. Ltd.拟向 All Circuits S.A.S.及 GDL Circuits S.A. de C.V.分别提供额度不超过 1700 万欧元、500 万美元的借款，All Circuits Holdings (Singapore) Pte. Ltd.届时按照借款协议的约定在上述额度内确认实际借款的金额，借款期限至《产权交易合同》项下的交割日之日起三年，分别按照年利率 3 month Euribor +1.26%、年利率 12 month SOFR+0.25%收取利息，具体以最终签署的借款协议为准。

2. 本次财务资助事项已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议及第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、对外提供借款事项概述

公司拟通过子公司 All Circuits Holdings (Singapore) Pte. Ltd.（以下简称“AC Holdings”）以支付现金的方式购买 Hiwinglex S.A.和 IEE International Electronics & Engineering S.A.（以下简称“IEE 公司”）合计持有的 All Circuits S.A.S.（以下简称“AC 公司”）100%股权以及 IEE 公司持有的 TIS Circuits SARL 0.003%股权（以下简称“本次交易”）。

GDL Circuits S.A. de C.V.（以下简称“GDL 公司”）为本次交易的标的公司 AC 公司的全资子公司。本次交易完成后，AC 公司及 GDL 公司将成为公司子公司。本次交易详情，请参见公司同日披露的《惠州光弘科技股份有限公司重大资产购买预案》。

截至公告日，AC 公司尚向 IEE 公司欠有借款本金 1,500 万欧元及根据相关借款协议规定所产生尚未支付的利息，GDL 公司尚向 IEE 公司欠有借款本金 417.7 万美元及根据相关借款协议规定所产生的尚未支付的利息。根据本次交易的方案，AC 公司及 GDL 公司应不晚于本次交易交割日向 IEE 公司偿还上述借款。

为了本次交易的顺利推进，公司的子公司 All Circuits Holdings (Singapore) Pte. Ltd. 拟向 All Circuits S.A.S.及 GDL Circuits S.A. de C.V.分别提供额度不超过 1700 万欧元、500 万美元的借款，All Circuits Holdings (Singapore) Pte. Ltd.届时按照借款协议的约定在上述额度内确认实际借款的金额，借款期限均为《产权交易合同》项下的交割日之日起三年，分别按照 3 month Euribor+1.26%、12 month SOFR+0.25%的年利率收取利息。

就上述借款事宜，公司的子公司 All Circuits Holdings (Singapore) Pte. Ltd.将作为出借人，分别与 AC 公司及 GDL 公司作为借款人签署借款协议。公司的子公司 All Circuits Holdings (Singapore) Pte. Ltd.、AC 公司以及 IEE 公司拟共同签署一份三方协议，AC 公司将根据三方协议指示 All Circuits Holdings (Singapore) Pte. Ltd.代为向 IEE 公司偿还 IEE 公司给 AC 公司的贷款及截止交割日根据相关借款协议产生的尚未支付的利息。公司的子公司 All Circuits Holdings (Singapore) Pte. Ltd.、GDL 公司以及 IEE 公司拟共同签署一份三方协议，GDL 公司将根据三方协议指示 All Circuits Holdings (Singapore) Pte. Ltd.代为向 IEE 公司偿还 IEE 公司给 GDL 公司的贷款及截止交割日根据相关借款协议产生的尚未支付的利息。

本次借款不影响公司正常业务开展及资金使用，也不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《惠州光弘科技股份有限公司章程》等规定的不得提供财务资助的情形。

本次财务资助事项已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议及第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、借款对象基本情况

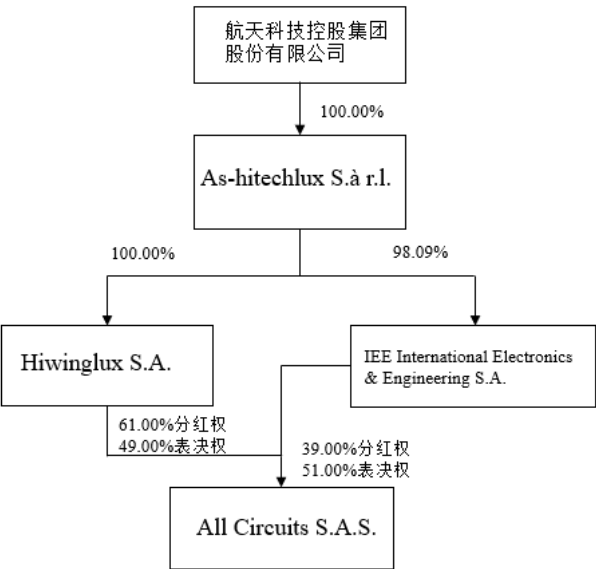
（一）All Circuits S.A.S.

- 1. 名称：All Circuits S.A.S.
- 2. 成立日期：2015 年 6 月 10 日
- 3. 住所：6 - 3ème avenue, Parc Synergie Val de Loire 45130 Meung-sur-Loire, France
- 4. 注册资本：69,000,000 欧元（已发行股份 69,000,000 股，每股面值 1 欧元）
- 5. 主营业务：AC 公司主要从事电子制造服务业务，其业务主要聚焦于汽车电子领域，并在电气、家电和医疗器械等制造业领域具有一定业务规模，主要为客户提供电子控制模块、电子产品制造及零配件组装服务。

6. 股东及股权结构如下：

序号	股东名称	股份数量（股）	持股比例
1	IEE International Electronics & Engineering S.A.	26,910,000	39%
2	Hiwinglex S.A.	42,090,000	61%
合计		69,000,000	100%

7. 产权及控制关系：



8. 主要财务如下：

单位：万元（人民币）

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	237,976.75	255,359.85
负债总额	169,690.62	183,791.20
所有者权益	68,286.13	71,568.66
项目	2024 年 1-6 月	2023 年度
营业收入	162,683.31	329,716.58
净利润	-1,881.09	5,409.16

9. AC 公司为公司拟现金收购的标的公司。本次交易完成后，公司将成为 AC 公司的控股股东。经查询，AC 公司不是失信被执行人。

10. 公司在上一会计年度未对 AC 公司提供过财务资助。

（二）GDL Circuits S.A. de C.V.

1. 名称：GDL Circuits S.A. de C.V.

2. 成立日期：2017 年 10 月 20 日

3. 住所：The Metropolitan Area of Guadalajara, Jalisco, Mexico, which includes the municipalities of Zapopán, Tlaquepaque, Tonalá and Tlajomulco de Zúñiga

4. 注册资本：50,000 墨西哥比索（已发行股份 48,038 股 A 系列股份，1,961 股 B 系列股份，每股面值 1 墨西哥比索）

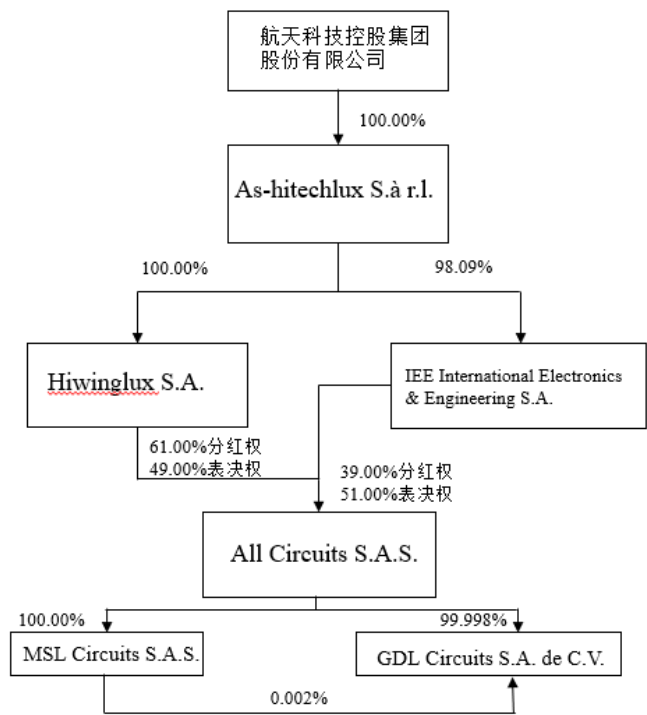
5. 主营业务：GDL 公司为 AC 公司的子公司，专注于为美洲客户提供服务。

6. 股东及股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（股）		股权比例
		A系列股份	B系列股份	
1	All Circuits S.A.S.	48,038	1,961	99.998%
2	MSL Circuits S.A.S.	1	-	0.002%
合计		50,000		100%

注：MSL Circuits S.A.S.为 AC 公司的全资子公司。

7. 产权及控制关系：



8. 主要财务如下：

单位：万元（欧元）

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	5,039.41	5,090.78
负债总额	6,138.73	6,026.65
所有者权益	-1,099.32	-935.87
项目	2024 年 1-6 月	2023 年度
营业收入	1,992.06	3,524.73
净利润	-429.63	-229.50

注：GDL 公司的以上数据未经审计。

9.AC 公司为公司拟现金收购的标的公司，GDL 为 AC 公司的全资子公司。本次交易完成后，公司将成为 GDL 公司的控股股东。经查询，GDL 公司不是失信被执行人。

10. 公司在上一会计年度未对 GDL 公司提供过财务资助。

三、借款协议主要内容

（一）AC 公司借款协议

1. 出借人: All Circuits Holdings (Singapore) Pte. Ltd.
2. 借款对象: All Circuits S.A.S.
- 3.借款金额: 不少于 IEE 公司给 AC 公司提供的贷款以及截止本次交易的交割日根据相关借款协议产生的尚未支付的利息的贷款
- 4.借款利率: 3 month Euribor+1.26%
- 5.借款期限: 《产权交易合同》项下的交割日之日起三年
- 6.借款用途: 用于偿还 AC 公司尚向 IEE 公司欠有借款本金 1,500 万欧元及根据相关借款协议规定所产生尚未支付的利息

（二）GDL 公司借款协议

1. 出借人: All Circuits Holdings (Singapore) Pte. Ltd.
- 2.借款对象: GDL Circuits S.A. de C.V.
- 3.借款金额: 不少于 IEE 公司给 GDL 公司提供的贷款以及截止本次交易的交割日根据相关借款协议产生的尚未支付的利息的贷款
- 4.借款利率: 12 month SOFR+0.25%
- 5.借款期限: 《产权交易合同》项下的交割日之日起三年
- 6.借款用途: 用于偿还 GDL 公司尚向 IEE 公司欠有借款本金 417.7 万美元及根据相关借款协议规定所产生的尚未支付的利息

相关借款协议以最终签署并执行的协议约定为准。

四、风险分析及风控措施

AC 公司及 GDL 公司经营情况稳定, 信誉良好。本次交易完成后, AC 公司及 GDL

公司将成为公司的子公司。公司将积极跟踪 AC 公司及 GDL 公司的经营状况，密切关注其资产负债等情况的变化，控制资金风险，确保公司资金安全。本次借款事项不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

五、董事会意见

董事会认为本次公司向 AC 公司及 GDL 公司提供财务资助主要是为了本次交易的顺利推进。本次的借款对象 AC 公司及 GDL 公司经营状况良好；本次交易完成后，AC 公司及 GDL 公司将成为公司的子公司，本次借款风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，本次借款事项符合公司整体利益。

六、独立董事意见

公司独立董事认为本次公司向 AC 公司及 GDL 公司提供财务资助主要是为了本次交易的顺利推进。本次交易完成后，AC 公司及 GDL 公司将成为公司的子公司，本次对外提供借款事项的决策程序合法合规，符合公司提供对外借款的相关规定，不会损害公司及股东的利益。因此，我们一致同意公司本次对外提供借款事项。

七、累计提供财务资助金额及逾期金额

截至本公告披露之日，公司提供借款的总余额为 0 万元。本次提供借款后，公司提供借款的总余额为 16,344.55 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.37%。在本次交易完成后，此次财务资助将变成公司对合并报表范围内的控股子公司提供的财务资助。公司不存在财务资助逾期未收回的情况。

八、备查文件

1. 惠州光弘科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；
2. 惠州光弘科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议

决议；

3. 借款协议。

惠州光弘科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 4 日